

01;03;04;11;12

©1995

**О СКОРОСТИ НАПЫЛЕНИЯ ПЛЕНОК  
НИТРИДА ТИТАНА  
В МАГНЕТРОННЫХ УСТАНОВКАХ  
РЕАКТИВНОГО РАСПЫЛЕНИЯ**

*B.B. Владимиров, О.А. Панченко*

1. Технология реактивного распыления (РР) получила обширное промышленное применение для получения различных покрытий [1], в том числе пленок нитрида титана (TiN). Требуемая стехиометрия достигается балансом потоков материала распыляемого катода (Ti) и частиц реактивного газа ( $N_2$ ) на подложку. Распыление катода осуществляется ионами плазмообразующего газа (Ar). В магнетронных распылительных системах (МРС) устойчивый режим РР возможен [2] только при достаточно больших скоростях откачки  $\chi$  ( $\text{см}^3/\text{с}$ ). При  $\chi < \chi_{cr}$  процесс напыления неустойчив, что связано с неоднозначной зависимостью парциального давления реактивного газа (РГ) в камере МРС от натекающего потока РГ. В результате неустойчивости система переключается в состояние с низкой скоростью напыления [3]. Если  $\chi \geq \chi_{cr}$ , указанная неоднозначность отсутствует и режим напыления устойчив. В работе [3] предложен метод расчета  $\chi_{cr}$  для получения пленок бинарных соединений. В настоящей статье впервые рассчитана скорость напыления ( $V$ ) и производительность МРС ( $K$ ) в случае пленок нитрида титана в зависимости от геометрических характеристик системы и параметров разряда при  $\chi = \chi_{cr}$ .

2. Исходные уравнения, описывающие стационарные характеристики процесса РР, определяются из условий баланса образования TiN на катоде, геттере и расхода натекающего газа ( $N_2$ ). Под геттером подразумевается вся поверхность (подложка, боковые стенки камеры), на которую поступает поток распыляемого металла. Эти уравнения имеют вид [2]:

$$2F(1 - \gamma_1) = (j/e)s_B\gamma_1, \quad (1)$$

$$2F(1 - \gamma_2) + (j/e)s_B\alpha^{-1}\gamma_1(1 - \gamma_2) = (j/e)s_M\alpha^{-1}(1 - \gamma_1)\gamma_2, \quad (2)$$

$$q = A_1 F[1 - \gamma_1 + \alpha(1 - \gamma_2) + \kappa], \quad (3)$$

где  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  — степени покрытия нитридом титана катода и геттера ( $\gamma_{1,2} < 1$ );  $F = Pv_T/kT$  — поток РГ в камере,  $P$  — парциальное давление РГ,  $v_T = \sqrt{kT/2\pi M} = 1.3 \cdot 10^4$  см/с,  $M$  и  $T$  — масса молекулы и температура РГ;  $s_B$  и  $s_M$  — коэффициенты распыления TiN и Ti на катоде ионами Ar;  $\alpha = A_2/A_1$  — отношение площадей геттера и эрозионной зоны катода;  $q(\text{с}^{-1})$  — темп натекания РГ;  $\varkappa = \chi/v_T A_1$ ;  $j$  — плотность ионного тока;  $e$  — заряд электрона.

При выводе (1) и (2) предполагалось, что при взаимодействии двухатомной молекулы РГ ( $N_2$ ) с атомами металла (Ti) образуются две молекулы TiN.

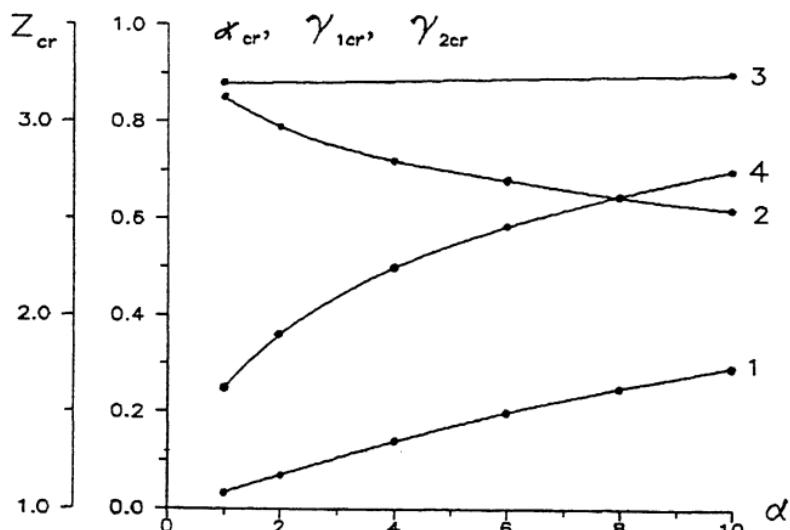
Согласно (1), (2) величины  $F$  и  $\gamma_2$  определяются через  $\gamma_1$ :

$$F = (s_B j / 2e) \left( \gamma_1 / (1 - \gamma_1) \right),$$

$$\gamma_2 = 1 - \frac{(1 - \gamma_1)}{(1 - \gamma_1)^2 + s\alpha\gamma_1 + s\gamma_1(1 - \gamma_1)}, \quad (4)$$

где  $s = s_B/s_M$ .

Подставляя выражения (4) в соотношение (3), можно получить алгебраическое уравнение четвертой степени для  $\gamma_1$ . Характер решений этого уравнения от величины  $q$  зависит [3] от следующих параметров:  $\varkappa$ ,  $\alpha$ ,  $s$ . Устойчивые решения (однозначно зависящие от  $q$ ) существуют только при  $\varkappa > \varkappa_{cr}$ . Эти решения подобны по величине параметра  $Z = 2qe/Is_B$ , где  $I$  — ток разряда.



Зависимость скорости критической откачки  $\varkappa_{cr}$  1, величин  $\gamma_{1cr}$  2,  $\gamma_{2cr}$  3 и скорости натекания азота  $Z_{cr}$  4 от соотношения площадей геттера и катода ( $\alpha$ ).

На рисунке представлены численные расчеты  $\chi_{cr}$  и величин  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $Z$  (при  $\kappa = \kappa_{cr}$ ) для случая TiN ( $S = 0.2$  [2]) в зависимости от параметра  $\alpha$ . Как видно из рисунка, при  $\kappa = \kappa_{cr}$  степень покрытия геттера нитридом титана велика ( $\gamma_2 \approx 0.9$ ) и слабо зависит от величины  $\alpha$ . Данные рисунка используются ниже при расчете основных характеристик промышленных MPC.

3. Учитывая уравнение (2), можно получить выражение для скорости напыления и производительности MPC:

$$V = (j/e)(s_m/N)\gamma_2(1 - \gamma_1), \quad (5)$$

$$K = (\tilde{A}_2/d)V, \quad (6)$$

где  $N = 5 \cdot 10^{22}$  см<sup>-3</sup> — плотность молекул TiN,  $\tilde{A}_2$  — площадь напыляемой подложки,  $d$  — толщина напыляемого слоя TiN.

При расчете величины  $V$  и  $K$  используется эмпирическое выражение для коэффициента распыления титана ( $s_m$ ) ионами аргона [4]:

$$s_m = 1.6\sqrt{U/10kV},$$

где  $U$  — напряжение на разряде.

В таблице, с учетом данных рисунка, представлены расчетные значения критической скорости откачки  $\chi_{cr}$ , темпа натекания азота  $q_{cr}$  и скорости напыления  $V$  для случая крупной промышленной MPC ( $A_1 = 10^3$  см<sup>2</sup>,  $j = 60$  мА/см<sup>2</sup>,  $U = 0.4$  кВ).

$\alpha$	1	2	3	4	5
$\chi_{cr}$ , л/с	520	910	1430	1820	2210
$q_{cr}$ , $10^{19}$ с <sup>-1</sup>	1.94	2.28	2.54	2.64	2.79
$V$ , Å/с	34	22	18	15	13

Как видно из таблицы, при увеличении  $\alpha$  значение  $V$  уменьшается ( $\sim 1/\sqrt{\alpha}$ ). Такой характер зависимости  $V(\alpha)$  можно обосновать аналитически с помощью уравнений (4) и (5) в предположении  $\gamma_2 = \text{const}$ . Используя рассчитанные значения  $V$ , нетрудно определить производительность MPC. Например, если  $d = 200$  Å,  $\tilde{A}_2 = 5 \cdot 10^2$  см<sup>2</sup>,  $\alpha = 1$ , то  $K = 30.6$  м<sup>2</sup>/ч; при  $\tilde{A}_2 = 2 \cdot 10^3$  см<sup>2</sup>,  $\alpha = 2.5$   $K = 70$  м<sup>2</sup>/ч.

Нетрудно показать, используя (5), (6), что при фиксированных площадях  $A_1$  и “холостой” части геттера (боковые стенки камеры) величина  $K$  изменяется  $\sim \sqrt{\tilde{A}_2}$ . При фиксированных значениях  $A_1$ ,  $\tilde{A}_2$  величина  $K \sim 1/\sqrt{\alpha}$ .

Полученные результаты представляют интерес при выборе геометрических параметров и рабочих режимов промышленных MPC.

### Список литературы

- [1] Westwood W.D. // Physics of Thin Films / Ed. by M.H. Francombe, J.L. Vossen. Academic, Boston, 1989. P. 1-79.
- [2] Larsson T., Blom H.O., Nender C., Berg S. // J. Vac. Sci. Technol. 1988. V. A6(3). P. 1832-1836.
- [3] Владимира В.В., Горшков В.Н., Мотрич В.А. и др. // ЖТФ. 1994. Т. 64. В. 5. С. 91-102.
- [4] Плещивцев Н.В. Катодное распыление. М.: Атомиздат, 1968. 343 с.
- [5] Черепин В.Т., Васильев Н.А. Справочник. Методы и приборы для анализа поверхности материалов: Киев: Наук. думка, 1982. 399 с.

Институт физики  
НАН Украины  
Киев

Поступило в Редакцию  
14 января 1995 г.